Neues für Advanced Packaging Prozesse





Mit Advanced-Packaging-Technologien lassen sich Dies und SMT-Bauteile zu extrem kompakten Submodulen und funktionsreichen Bauteilen integrieren und damit die Voraussetzung fu?r neue Elektronik-Anwendungen in verschiedensten Branchen schaffen. Technologiefu?hrer ASM bietet ein großes Portfolio an modernsten Advanced-Packaging-Lo?sungen, die sich zu kompletten Prozessketten – von Wafer-Entnahme und Fan-out der Dies u?ber das Bonding bis hin zum Molding und Packaging – reihen lassen.

Bewertung: Noch nicht bewertet **Preis** ermäßigter Preis2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

1 / 1